PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-283373

(43)Date of publication of application: 31.10.1997

(51)Int.Cl.

H01G 7/02

(21)Application number: 08-092823

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22)Date of filing:

15.04.1996

(72)Inventor: ICHIYA MITSUO

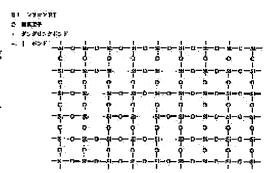
NAKAMURA TAKURO KASANO FUMIHIRO TOMONARI SHIGEAKI JIYATSUKII REBUINAA

(54) SILICON OXIDE FILM ELECTRET

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a long-life silicon oxide film elelctret by using a silicon oxide film contg. Si atoms each coupled with three oxygen atoms and having a dangling bond.

SOLUTION: A silicon oxide film composed of Si atoms mostly each coupled with four oxygen atoms contains Si atoms each coupled with three oxygen atoms and having a dangling bond (≡Si.or.Si≡). The dangling density is approximately 1013–1019cm–3 and the number of oxygen atoms is less than twice the number of Si atoms. This provides a long-life silicon oxide film electret good in heat resistance.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-283373

(43)公開日 平成9年(1997)10月31日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01G 7/02

H01G 7/02

Α

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

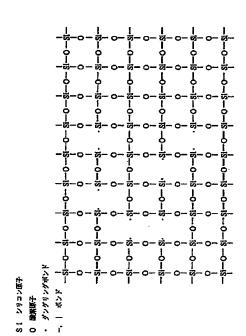
(21)出願番号	特顧平8-92823	(71) 出題人 000005832
		松下電工株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)4月15日	大阪府門真市大字門真1048番地
		(72)発明者 一矢 光雄
		大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
		式会社内
		(72)発明者 中邑 卓郎
		大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
		式会社内
	•	(72)発明者 笠野 文宏
		大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
		式会社内
		(74)代理人 弁理士 石田 長七 (外2名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シリコン酸化膜エレクトレット

(57)【要約】

【課題】寿命が長いシリコン酸化膜エレクトレットを提供する。

【解決手段】 シリコン原子(Si)の多くが4つの酸素原子(O)と結合して構成されるシリコン酸化膜中に、3つの酸素原子と結合し且つダングリングボンドを有するシリコン原子が存在しており、このダングリングボンドに電荷を保持させている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン酸化膜中に、3つの酸素原子と 結合し且つダングリングボンドを有するシリコン原子が 存在して成ることを特徴とするシリコン酸化膜エレクト レット。

【請求項2】 ダングリングボンド密度が略1013cm -3乃至略1019 c m-3であることを特徴とする請求項1 記載のシリコン酸化膜エレクトレット。

【請求項3】 酸素原子の数が、シリコン原子の数の2 倍未満であることを特徴とする請求項1記載のシリコン 10 があるという問題があった。 酸化膜エレクトレット。

【請求項4】 酸素原子の数が、シリコン原子の数の略 1. 7倍であることを特徴とする請求項3記載のシリコ ン酸化膜エレクトレット。

【請求項5】 水素又は窒素を含有して成ることを特徴 とする請求項1記載のシリコン酸化膜エレクトレット。 【請求項6】 水素の不純物を略10原子パーセント、 窒素の不純物を略 1 原子パーセント有していることを特 徴とする請求項3記載のシリコン酸化膜エレクトレッ ١.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気的に帯電した シリコン酸化膜よりなるシリコン酸化膜エレクトレット に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、永久電荷を有する絶縁膜であ るエレクトレットは、静電形マイクロホンや静電リレー 等に用いられている。従来のエレクトレット材料として は有機(高分子重合体)材料が使用されているが、近年 30 では、IC・LSI等の半導体の微細加工技術を利用し てエレクトレットの薄膜化・小型化を図るために、有機 材料よりなる重合体エレクトレットに代わるものとし て、シリコン酸化膜エレクトレットが検討されている。 【0003】シリコン酸化膜エレクトレットは、重合体 エレクトレットに比べて、(1)高温でも良好な帯電安 定性を有する、(2)薄膜(例えば、厚さ10μm以 下) 化が容易である、(3) 熱酸化法、プラズマCVD 法、LPCVD法等の従来の半導体製造プロセスによっ に形成することができる、等の利点を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来のシリ コン酸化膜エレクトレットの期待寿命は、数カ月程度で あり、重合体エレクトレットの寿命よりも短いという問 題があった。そこで、シリコン酸化膜エレクトレットの 期待寿命を増大する手段として、シリコン酸化膜を電気 的に帯電させる前に、ヘキサメチルジシランザン (HM DS) によって前記シリコン酸化膜を化学的に処理する

悪く、期待寿命の増大効果も少ない。

【0005】このため、熱酸化法によってシリコン基板 上に形成したシリコン酸化膜を電気的に帯電させる前 に、シリコン酸化膜をアニール (予熱) するという技術 が提案されている (the 7th international symposium on electrets (1991) 663,668)。しかしながら、予熱を 行ったことによって期待寿命 (life expectancy)が著し く増大することはなく、この予熱によって、シリコン酸 化膜エクトレットの帯電安定性を低下させてしまうこと

【0006】本発明は上記事由に鑑みて為されたもので あり、その目的は、寿命が長いシリコン酸化膜エレクト レットを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、上記 目的を達成するために、シリコン酸化膜中に、3つの酸 素原子と結合し且つダングリングボンドを有するシリコ ン原子が存在して成ることを特徴とするものであり、ダ ングリングボンドが存在していることによりバンドギャ ップの略中央のフェルミエネルギ付近にギャップ中電子 状態が作られ、この電子状態の電子エネルギ準位を作っ ているダングリングボンドに電荷が電気的に固定される ので、その結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化 膜エレクトレットを提供することができる。

【0008】請求項2の発明は、ダングリングボンド密 度が略1013cm-3乃至略1019cm-3なので、フェル ミエネルギ近くにこの電子状態の電子エネルギ準位が作 られ、この電子状態の電子エネルギ準位を作っているダ ングリングボンドに電荷が電気的に固定されて、その結 果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクトレ ットを提供することができる。

【0009】請求項3の発明は、酸素原子の数が、シリ コン原子の数の2倍未満なので、シリコンのダングリン グボンドが形成されることによって、バンドギャップの 略中央のフェルミエネルギ付近にギャップ中電子状態が 作られて、この電子状態の電子エネルギ準位を作ってい るダングリングボンドに電荷が電気的に固定され、その 結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクト レットを提供することができる。

て基板上に(熱酸化法の場合はシリコン基板上に)容易 40 【0010】請求項本の発明は、酸素原子の数が、シリー コン原子の数の略1.7倍なので、シリコン原子の数が 酸素原子に対して過剰となってダングリングボンドが形 成され、バンドギャップの略中央のフェルミエネルギ付 近にギャップ中電子状態が作られて、この電子状態の電 子エネルギ準位を作っているダングリングボンドに電荷 が電気的に固定される。その結果、耐熱性が良好で長寿 命なシリコン酸化膜エレクトレットを提供することがで きる。

【0011】請求項5の発明は、請求項1の発明におい 技術が提案されているが、この技術は制御性・再現性が 50 て、水素又は窒素を含有しているので、熱処理を行うこ

とによってダイングリングボンドを増やすことができ る。請求項6の発明は、請求項3の発明において、水素 の不純物を略10原子パーセント、窒素の不純物を略1 原子パーセント有しているので、HやNの一部は荷電し た形で入っており、中性条件を満たすために、シリコン のダングリングボンドが荷電し、ダングリングボンドに 電荷が固定される。その結果、耐熱性が良好で長寿命な シリコン酸化膜エレクトレットを提供することができ る。

[0012]

【実施の形態】図1に本実施の形態のシリコン酸化膜エ レクトレットの結合の様子の模式図を示す。ここで、図 1中の「・」はシリコン原子 (Si) のダングリングボ ンド(未結合手)を示している。本実施の形態のシリコ ン酸化膜エレクトレットは、図1に示すように、シリコ ン原子の多くが4つの酸素原子(O)と結合して構成さ れるシリコン酸化膜中に、3つの酸素原子と結合し且つ ダングリングボンドを有するシリコン原子 (以下、ダン グリングボンドを有するシリコン原子を「≡Si・」又 は「·Si≡」と記す)が存在していることにある。こ 20 のため、本実施の形態のシリコン酸化膜エレクトレット は、ダングリングボンドが存在していることによりフェ ルミエネルギ付近にギャップ中電子状態が作られるの で、この電子状態の電子エネルギ準位に電荷が電気的に 固定され、つまり、ダングリングボンドに電荷が捕獲 (トラップ)され、その結果、高い温度が加えられなけ れば放電されず、耐熱性が良好で電荷保持力が大きく長 寿命なエレクトレット特性を有するシリコン酸化膜エレ クトレットが得られるのである。

【0013】なお、図1及び後述の図2、図3、図9で 30 は、模式的に2次元の正方格子状の構造にしてあるが、 実際はシリコン原子の周りを正四面体構造に4つの酸素 原子が取り囲んでいて、このような四面体が隅の酸素原 子を介してお互いに結びついている構造になっている。 ところで、シリコン原子は4本の結合手を、酸素原子は 2本の結合手をそれぞれ有しているため、純粋なシリコ ン酸化膜(SiO2)の結合は図9に示す模式図のよう な構造になっている。これに対し、本実施の形態のシリ コン酸化膜エレクトレットでは、シリコン原子のダング リングボンドを有し、図3に示すように、このダングリ 40 ングボンドに酸化水素(OH)や酸化窒素(ON)が結 合した構造でもよいし、水素原子 (H) や窒素原子 (N)が結合した構造のものでもよい。なお、HやOは

原子間に存在してもよい。 【0014】以下、上記シリコン酸化膜エレクトレット の製造方法について説明する。まず、シリコン基板上又 はシリコン以外の材料からなる基板上にシリコン原子の

ダングリングボンドを有するシリコン酸化膜を形成す る。ここで、シリコン酸化膜は、基板がシリコン基板で てシリコン酸化膜を成長させる所謂熱酸化法によって形 成することができる。熱酸化法としては、水分(H

2 〇)を含む酸素ガス中で成長させる所謂ウェット酸化 法と、高純度の乾いた酸素ガス中で成長させる所謂ドラ イ酸化法の何れの方法を用いてもよい。また、シリコン 以外の材料からなる基板を用いる場合には、Siを含む 原料ガス (例えば、モノシラン: SiH4)と酸素を含 む原料ガス (例えば、亜酸化窒素: N2 O) とを気相に て供給し、原料ガスそれぞれを分解して基板上にシリコ 10 ン酸化膜を堆積させる所謂CVD法によって形成するこ とができる。なお、シリコン基板上にCVD法によって シリコン酸化膜を堆積してもよいことは勿論である。

【0015】CVD法によってシリコン酸化膜を堆積す るには、例えば図4に示すような平行平板型のプラズマ CVD装置30において、接地された下部電極32上に 基板2を保持し、原料ガス (例えば、SiH4 及びN2 〇)をガス導入口33を介して減圧状態の反応室31内 に導入するとともに、高周波電源ACから周波数が例え ば13.56MHzの高周波電圧を上部電極34に印加 することによりプラズマを発生させ、基板2上にシリコ ン酸化膜1を堆積させる。この時の化学反応は例えば下 記のように記述される。

 $SiH_4 + 2N_2 O \rightarrow SiO_2 + 2H_2 + 2N_2$ ここで、ストイキオメトリイに合ったSiO2膜を形成 することができるガス流量比の時に比べて、SiH4ガ スをN2 Oガスに対して過剰に供給することによって、 SiO2 を所謂シリコンリッチ(Si-rich)の状 態にして(つまり、酸素原子が不足している状態にし て)シリコン原子のダングリングボンドを形成してい る。この時、シリコン酸化膜1中の酸素原子の数はシリ コン原子の数の2倍未満である。ところで、上記シリコ ン酸化膜1は、堆積時に酸素原子が不足しているため、 シリコン原子のダングリングボンドが発生し、このダン グリングボンドにSiH4 ガスのHやN2 OガスのN等 が不純物として混入しやすくなり (オートドーピングさ れやすくなり)、Si-OH, Si-H, Si-ON, Si-N等の結合や、HやN等の格子間原子を含んでい

【0016】なお、CVD法でのシリコン酸化膜の形成 はプラスマCVD法に限定するものではなく、例えば、 原料ガスを減圧状態で熱分解して基板上に堆積させるし PCVD法等によって形成してもよい。基板2上にシリ コン酸化膜1を形成した後は、例えば図5に示すような 熱処理装置40において、清浄空気、H2ガス、Arガ ス、N2 ガス等の何れかをガス導入口43を介して熱処 理室41に導入しヒータ内蔵の基板支持台42上にシリ コン酸化膜1が形成された基板2を載せ、この基板2を 所定時間(例えば、1時間)だけ加熱(100℃以上) してその後室温まで冷却する熱処理を行う。ここで、熱 ある場合には、シリコン基板を高温酸素雰囲気中に入れ 50 処理前のシリコン酸化膜中に水素に関する不純物が多く

5

含まれる場合、このシリコン酸化膜を例えば清浄空気中 にて熱処理することにより、例えば、

 $\equiv Si - O - Si \equiv +2H \rightarrow \equiv Si \cdot + \cdot Si \equiv +H_2$

のような反応が生じ、シリコンのダングリングボンドが 新たに形成される。また、≡Si−Si≡のようなSi -Si結合においても、熱処理することによってSi-Si結合が切れて、

 $\equiv Si - Si \equiv \rightarrow \equiv Si \cdot + \cdot Si \equiv$

る。つまり、本実施の形態の製造方法では熱処理を行う ことによって、ダングリングボンドの数を熱的に安定化 しているのである。

【0017】なお、熱処理装置は図5の構成に限定する ものではなく、加熱処理が行える装置であればよい。熱 処理工程が終了した後は、シリコン酸化膜1を電気的に 帯電させることによってシリコン酸化膜エレクトレット を形成する。具体的な帯電方法としては、例えば図6に 示すように電子銃から電子ビームをシリコン酸化膜へ向 けて照射して電子をシリコン酸化膜に導入することによ 20 固定電極19と、絶縁材料からなるワッシャーリング2 って帯電させる。また、別の帯電方法として、例えば図 7に示すような伝導性ワイヤ13と、伝導性ワイヤ13 のカバー14と、グリッド16と、伝導性支持部材15 とからなる帯電装置において、電圧Vの伝導性ワイヤ1 3よりコロナ放電にて発生した電荷をグリッド16の電 圧Vo により電荷量を調節して伝導性支持部材15上方 のシリコン酸化膜1に導入することによって帯電させ る。ここで、伝導性ワイヤ13に印加する電圧V及びグ リッド16に印加する電圧Voは、例えば、それぞれー 7000ボルト及び-200ボルト程度である。ところ 30 で、帯電を行うシリコン酸化膜1はシリコン原子のダン グリングボンドを有するので、正の帯電を行う場合、例 えば、

 $\equiv Si \cdot \rightarrow \equiv Si^+$

のように、ダングリングボンドに正の電荷がトラップさ れる。つまり、ダングリングボンドが存在していること によりフェルミエネルギ付近にギャップ中電子状態が作 られ、この電子状態の電子エネルギ準位に電荷が電気的 に固定され、つまり、ダングリングボンドに電荷がトラ ップされ、その結果、高い温度が加えられなければ放電 されず、耐熱性が良好で電荷保持力が大きく長寿命なエ レクトレット特性を有するシリコン酸化膜エレクトレッ トが得られるのである。

【0018】ところで、上述の製造方法によって形成し た長期安定性に優れた(数カ年のオーダの寿命を有す る)シリコン酸化膜エレクトレットでは、酸素原子の数 がシリコン原子の数の略1.7倍であり、3つの酸素と 結合し且つダングリングボンドを有するシリコン原子の ダングリングボンド密度は例えば略1. 4×1018cm -3であった。ダングリングボンド密度は略1013cm-3 50 いてもよい。

乃至略1019 c m-3であることが望ましい。ここで、酸 素原子の数及びシリコン原子の数はSIMS(Seco ndary Ion Mass Spectrosco ру) 法により求めた値を用い、ダングリングボンド密 度はESR(Electron SpinResona nse)法によって求めた値を用いている。また、この シリコン酸化膜エレクトレットは水素の不純物を略10 原子パーセント、窒素の不純物を略1原子パーセント有 していることをSIMS法により確認している。なお、 のようにシリコン原子のダングリングボンドが形成され 10 HやNの一部は荷電した形で入っており、中性条件を満 たすために、シリコンのダングリングボンドが荷電し、 . ダングリングボンドに電荷が固定されるものと考えられ 3.

> 【0019】図8に、上記構成のシリコン酸化膜エレク トレットを用いて構成したマイクロホン又はイヤホン等 の音響装置の側断面図を示す。この音響装置は、断面形 状が略C字状の金属ケース17と、金属ケース17の中 に収納される断面形状が略U字状で絶縁材料からなる部 材18と、部材18の両端に固定される金属板からなる 0を挟んで固定電極19と対向して平行に配置される金 属箔からなり音圧によって振動する振動板電極5と、振 動板電極5の固定電極19と対向する側の表面に形成さ れているシリコン酸化膜エレクトレット1'とを備え、 振動板電極5は導電材料からなるリング23を介してケ ース17に電気的に接続されている。 金属ケース17、 固定電極19はそれぞれピン21、22に電気的に接続 されており、ピン21、22を介して外部の電気回路に 接続することができる。ここで、シリコン酸化膜エレク トレット1'と固定電極19との間には空気層ができ る。このため、この音響装置を例えばマイクロホンとし て用い、ピン21、22を介して電源電圧が供給されて いる時、音圧によって振動板電極5が振動して電極間隔 (振動板電極5と固定電極19との距離)が変わるとと もに静電容量が変化し、このとき生じる電圧がピン2 1、22を介して音声信号として取り出されるのであ る。また、シリコン酸化膜エレクトレット1'を設ける ことによって各電極間のクーロン力を強めているので、 マイクロホンとして使う場合は感度を高めることができ

> 【0020】ところで、上記音響装置は、シリコン酸化 膜エレクトレット1'の厚さは0.5 μ m~3 μ m程度 の薄膜に形成してあるので、電極間隔を小さくすること ができ、振動板電極5の振動による静電容量の変化を大 きくすることができる。なお、シリコン酸化膜エレクト レット1'は、振動板電極5に形成することを限定する ものではなく、固定電極19の振動板電極5と対向する 側の表面に形成してもよく、この場合は、固定板電極1 9として高濃度の不純物が添加されたシリコン基板を用

۵.

[0021]

【発明の効果】請求項1の発明は、上記目的を達成するために、シリコン酸化膜中に、3つの酸素原子と結合し且つダングリングボンドを有するシリコン原子が存在しているので、ダングリングボンドが存在していることによりバンドギャップの略中央のフェルミエネルギ付近にギャップ中電子状態が作られ、この電子状態の電子エネルギ準位を作っているダングリングボンドに電荷が電気的に固定されるので、その結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクトレットを提供することができ10るという効果がある。

【0022】請求項2の発明は、ダングリングボンド密度が略10¹³ cm⁻³乃至略10¹⁹ cm⁻³なので、フェルミエネルギ近くにこの電子状態の電子エネルギ準位が作られ、この電子状態の電子エネルギ準位を作っているダングリングボンドに電荷が電気的に固定されて、その結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクトレットを提供することができるという効果がある。

【0023】請求項3の発明は、酸素原子の数が、シリコン原子の数の2倍未満なので、シリコンのダングリン 20 グボンドが形成されることによって、バンドギャップの略中央のフェルミエネルギ付近にギャップ中電子状態が作られて、この電子状態の電子エネルギ準位を作っているダングリングボンドに電荷が電気的に固定され、その結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクトレットを提供することができるという効果がある。

【0024】請求項4の発明は、酸素原子の数が、シリコン原子の数の略1.7倍なので、シリコン原子の数が酸素原子に対して過剰となってダングリングボンドが形成され、バンドギャップの略中央のフェルミエネルギ付 30近にギャップ中電子状態が作られて、この電子状態の電子エネルギ準位を作っているダングリングボンドに電荷が電気的に固定される。その結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクトレットを提供することがで

【図2】

きるという効果がある。

【0025】請求項5の発明は、請求項1の発明において、水素又は窒素を含有しているので、熱処理を行うことによってダイングリングボンドを増やすことができる。請求項6の発明は、請求項3の発明において、水素の不純物を略10原子パーセント、窒素の不純物を略1原子パーセント有しているので、HやNの一部は荷電した形で入っており、中性条件を満たすために、シリコンのダングリングボンドが荷電し、ダングリングボンドに電荷が固定される。その結果、耐熱性が良好で長寿命なシリコン酸化膜エレクトレットを提供することができるという効果がある。

8

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態のシリコン酸化膜エレクトレットの 結合の様子を示す模式図である。

【図2】実施の形態のシリコン酸化膜エレクトレットの 別の結合の様子を示す模式図である。

【図3】実施の形態のシリコン酸化膜エレクトレットの また別の結合の様子を示す模式図である。

【図4】シリコン酸化膜の形成に用いる装置の概略構成 図である。

【図5】シリコン酸化膜の熱処理に用いる装置の概略構 成図である。

【図6】電子銃による帯電方法の説明図である。

【図7】コロナ放電による帯電方法の説明図である。

【図8】実施の形態のシリコン酸化膜エレクトレットを 備えた音響装置の概略断面図である。

【図9】純粋なシリコン酸化膜の結合の様子を示す模式 図である。

【図5】

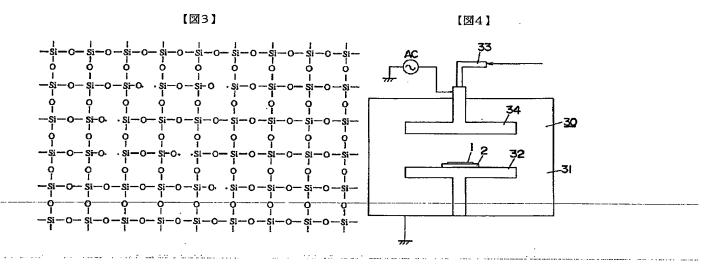
0 【符号の説明】

Si シリコン原子

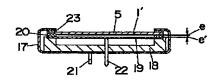
O 酸素原子

- ・ ダングリングボンド
- ー, | ボンド

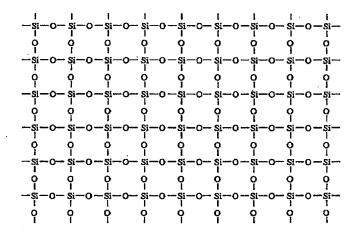
-\$i - 0 - \$i - 0 - \$i



【図8】



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 友成 恵昭

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株 式会社内

(72)発明者 ジャッキー レヴィナー

フランス国 92210 サンークルー アベ

ニュー ド シュレヌ 7